产品规格书/ SPECIFICATION		型号	YSX321SL	

● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标	Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)	SEAM 3.2*2.5		
2.Mode of Oscillation （振动模式）	Fundamental		
3. Frequency （标称频率）	12.000000		MHz
4.Load Capacitance (CL)（负载电容）	20		pF
5.Shunt Capacitance (Co)（静态电容）	1	1.5	pF
6. Equivalent Resistance （谐振电阻）		60	Ω
7.Frequency Tolerance at 25℃ （调整频差）	-10	10	ppm
8.Stability over operation temperance （温度频差）	± 30		ppm
9.Insulation Resistance (at DC 100V)（绝缘电阻）	500		MΩ
10.Drive Level （激励功率）	100		uw
11.Operating Temperature Range （工作温度范围）	-40	85	℃
12. Storage Temperature Range （储存温度范围）	-40	85	℃
13.Aging （老化率）	± 3		ppm/year
14.Other(其他)	0		

Aging

15. 标字 Marking

1.
```
YXC
12.0SBJ
```

2.
```
YXC
12.0SBJ
```
— YANGXING Logo
— Operating Temperature Code
— Production Line
— PPM Code
— PF Code
— Frequency Code

16. 外形尺寸　　3.2*2.5*0.70mm
    Dimensions

测试仪表 Equipment　　250B Crystal Impedance Meter

Ⅶ. **SMD3225 晶体外型/编带尺寸** Dimensions   UNIT: mm

Top View

Side View

Top View Perspective Crystal Connection

Top Perspective View

Top Perspective View Suggested Layout
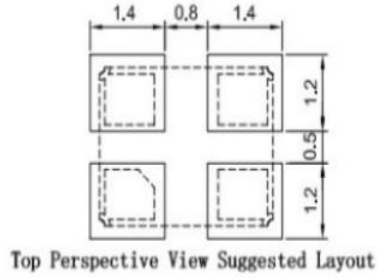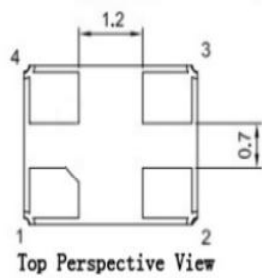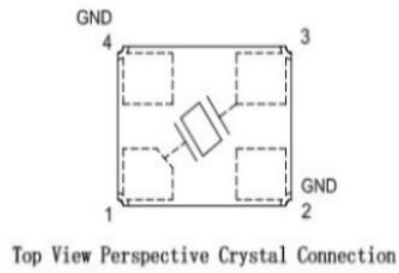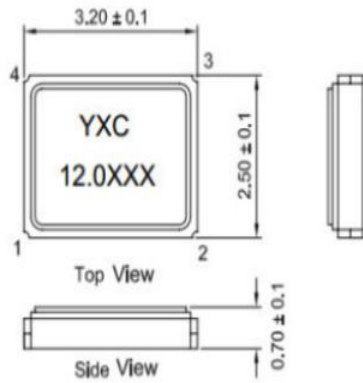
Units: mm
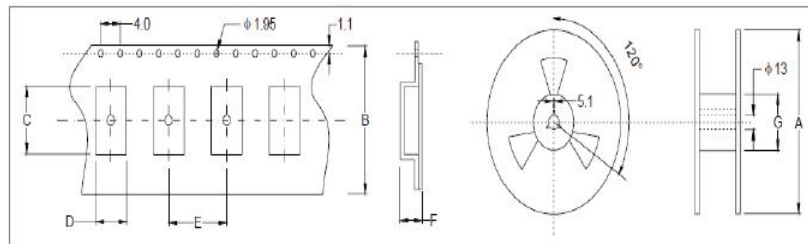
|	A	B	C	D	E	F	G
SMD3225	178±2.0	8.03±0.3	3.81±0.10	3.04±0.10	3.84±0.1	1.54±0.10	62.0±1.0
3000 pcs per reel							

SMD3225 编带尺寸图（mm）

● SUGGESTED REFLOW PROFILE （回流焊曲线图）

Total time:200sec.Max. （总时间：200秒　最大）

Solder melting point:220℃（熔点220 ℃ ）

Profiles Feature（特性）		Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)	平均升温速度	3℃/second Max
Preheat	预热	
■ Temperature Min (Ts min)	最低温度	125℃
■ Temperature Max (Ts max)	最高温度	200℃
■ Time (ts min to ts max)	从最低到最高时间	(60～180) seconds
Time maintained above	维持上述时间	
■ Temperature(T1)	温度	217℃
■ Time(tp)	时间	(60～150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp)	最高点温度	260 ℃
Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp)	高温维持时间	(20～40) seconds
Ramp-down rate	降温速度	6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature	从25℃到最高温度的时间	8 minutes max
Suggest reflow times	建议 reflow次数	3 Times max
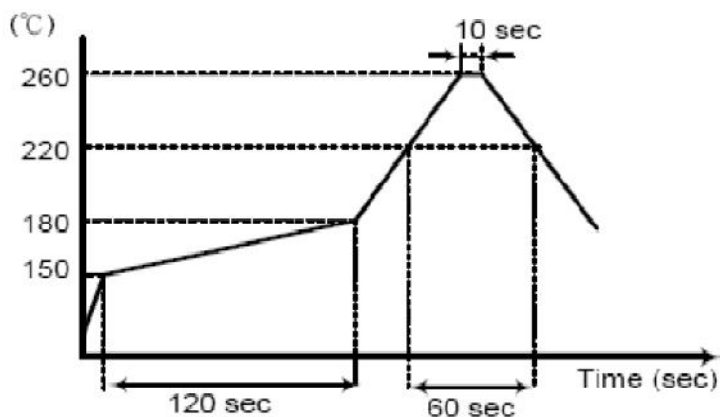
● RELIABILITY SPECIFICATIONS（信赖度试验）

No	Test Item（测试项目）	Test Conditions（测试条件）	Reference（参考）
1	High Temperature High Humidity Storage (高温、高湿、储存)	Temperature: 85℃±3℃ 温度: 85℃±3℃ Relative Humidity:85%RH 相对湿度: 85%RH Time: 96 Hours 时间: 96小时	JIS C5023
2	High Temperature Storage (高温储存)	Temperature: 125℃±3℃ 温度:125℃±3℃ Time: 96 Hours 时间:96 小时	MIL-STD-883E Method 1005.8
3	Low Temperature Storage (低温储存)	Temperature: -40℃±3℃ 温度: -40℃±3℃ Time: 96Hours 时间: 96小时	MIL-STD-883E Method 1013
4	Thermal Shock (温度冲击)	Temperature1:-55℃±5℃ 温度1:-55℃±5℃ Temperature2:85℃±5 ℃ 温度2: 85℃±5 ℃ Temperature change between T1 and T2 5 min T1和T2温度在5分钟内改变 10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone cycle 每次循环30分钟共10次	MIL-STD-202F Method 107 Condition A
5	RESISTANCE TO SOLDER HEAT (耐焊姿热)	Solder Temperature: 260℃±5℃ 焊槽温度:260℃±5℃ Time: 10±1 Seconds 时间:10±1秒	MIL-STD-202F Method 210E
6	Solderability(可焊性)	The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell time 5±0.5sec 245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒	J-STD-002B
7	Drop Test (落下试验)	3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm thickness hard wood board 从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上	JIS C6701
8	MECHANICAL SHOCK (机械冲击)	Half sine wave,1000 G 半正弦波,加速度1000G 3 Times for all 3 directions X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次	MIL-STD-202F Method 213B
9	Vibration (机械振动)	Frequency Range: 10Hz～55Hz 频率范围: 10Hz～55Hz Amplitude: 0.75mm 振幅: 0.75mm 2 Hours in each direction, total 6 Hours X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时	MIL-STD-883E Method 2007.3
10	Leakage Test (气密性)	Take measurements with a helium Leakage detector 氦质检漏 Leakage Rate≤1×10⁻³Pa cm³/s 漏率≤1×10⁻³Pa cm³/s	MIL-STD-883E